

深圳天德钰科技股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 730,857,936.85 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税）。截至 2025 年 2 月 28 日，公司总股本 409,021,341 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,853,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,244,118.03 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 29,244,118.03 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 52,549,893.53 元，现

金分红和回购金额合计 81,794,011.56 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 29.76%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 29,244,118.03 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 10.64%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	29,244,118.03	22,705,767.34	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	274,880,771.00	112,835,159.59	129784761.01
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	730,857,936.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	51,949,885.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	172,500,230.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	51,949,885.37		
现金分红比例（%）	30.12		

现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	469,195,649.01
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,509,169,911.11
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	10.41
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 274,880,771.00 元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，当年采用集中竞价方式，当年已实施的股份回购金额）为 81,794,011.56 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业及其特点

公司所属行业为公司所属行业为集成电路设计行业，具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的特点。投入大，回报周期长。行业市场竞争激烈，需要持续研发投入、快速产品更迭及加强供应链产能保障，以不断提升公司的核心竞争力。

（二）发展阶段及自身经营模式

公司始终定位移动智能终端关键芯片和智能物联领域芯片和方案的研发设计。坚持自主创新的研发模式，以面向行业前沿技术和市场需求为研发导向，凭借扎实的技术积累、强大的供应链垂直整合能力、较高的产品性价比，立志成为移动智能终端领域和智能物联领域的关键芯片的领航者。采用 Fabless 经营模式，专注于产品的研发、设计和销售环节，产品生产及封装测试分别由晶圆生产企业及封装测试企业完成。

（三）盈利水平及资金需求；

在报告期内，公司实现销售收入 21.02 亿元，同比增长 73.88%，归属于母公司股东的净利润 2.75 亿元，同比增长 143.61%。2024 年 12 月 31 日，公司经营情况和偿债能力良好。

2025 年公司将加大在各产品领域的研发投入，全力推进技术升级及新技术的研发，稳步提升公司产品竞争力。在充分考虑了目前的行业发展状况、公司发展战略等因素后，公司决定留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司经营目标的实现。

（四）上市公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况；

公司 2024 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发投入、项目建设、设备购置及生产经营发展等方面带来的营运资金的需求。同时公司保留充足现金储备寻求可能的并购机会推动产业并购及整合，提升公司核心竞争力，进一步提升公司的行业地位。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，提升公司盈利能力，为投资者创造更大的价值，给投资者带来长期持续的回报。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该

方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月26日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》，公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定，利润分配预案是结合公司2024年的经营情况及2025年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日